

A. Interconnect & Package 분과

Room H

하나스퀘어 (B115)

일 시 : 2월 17일(금) 09:30-11:00

세션명 : [FH1-A] 패키징 세션 I

좌 장 : 안은철(삼성전자), 이후정(성균관대학교)

FH1-A-1 09:30-10:00 **[Invited]** 3D Packaging Trends

저자: 황태주

소속: 삼성전자 반도체연구소

FH1-A-2 10:00-10:30 **[Invited]** RF Characteristic Study of MCP with Modified Package Substrate

저자: Woong-Sun Lee¹, Sang-Joon Lim¹, Heung-Jae Shin¹, Jong-Tae Lee², Jung-Kwon Park², Qwan-Ho Chung¹, and Kwang-Yoo Byun¹

소속: ¹PKG R&D, Hynix Semiconductor Inc., ²R&D Department Simmtech Co., Ltd.

FH1-A-3 10:30-11:00 **[Invited]** Mechanical and Electrical Reliabilities of Metallic Bonds for 3D Integration

저자: 박영배, 곽병현, 김재명, 박종명, 김성혁, 김정규

소속: 안동대학교 신소재공학부 청정에너지 소재기술연구센터